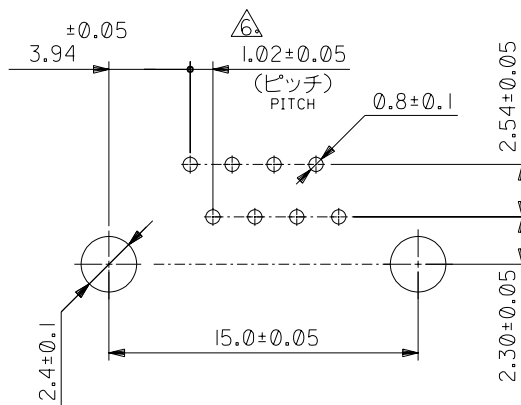
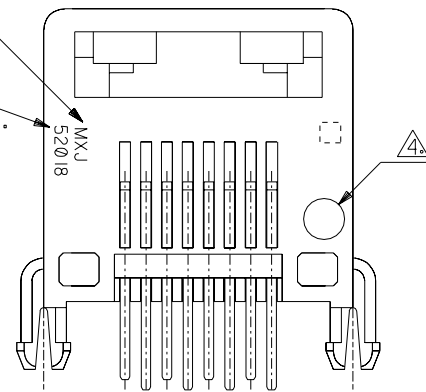
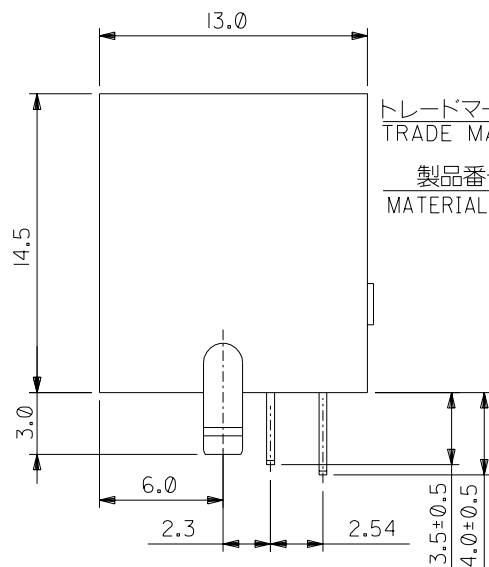
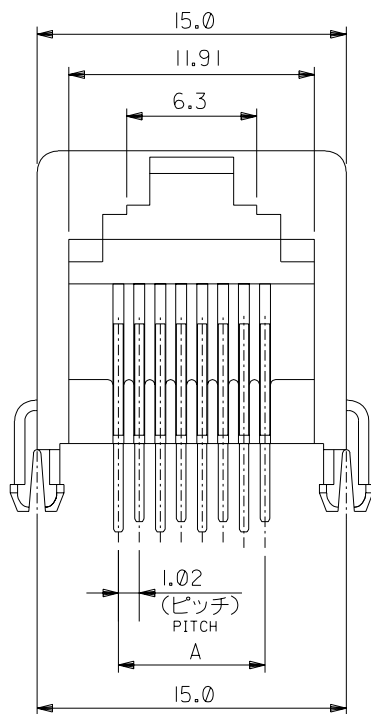
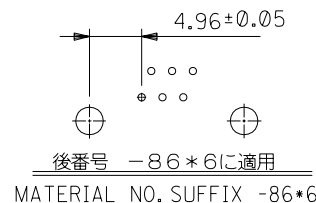
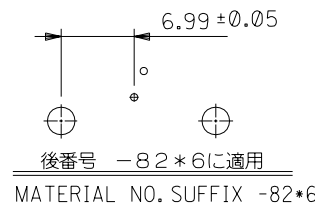




後番号 -88*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -88*6



後番号 -86*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -86*6



後番号 -82*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -82*6

基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)

角度	ANGLE	±3°
30°以上	OVER	±0.3
10°以上 30°未満	OVER UNDER	±0.25
10°未満	UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

0	新規作成 RELEASED	04/04/28	04/04/28
1	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	DATE
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			

注) NOTES

1. 材質 MATERIAL

ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM.: PHOSPHOR BRONZE

2. メッキ仕様 PLATING

接点部: 金メッキ、表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 錫メッキ 1.0µmMIN.
SOLDER AREA: TIN 1.0µmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.
UNDERPLATE: NICKEL 1.0µmMIN.

3. 推奨基板厚: t=1.6±0.05

RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05

4. 金メッキ厚標示

COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING

黄色: 0.1µmMIN. 緑色: 0.38µmMIN.
YELLOW: 0.1µmMIN. GREEN: 0.38µmMIN.
オレンジ色: 0.76µmMIN. 無色: 1.27µmMIN.
ORANGE: 0.76µmMIN. UNMARKED: 1.27µmMIN.

5. ハウジングの色は、グレイ。

HOUSING COLOR IS GRAY.

6. 公差非累積。

NON-ACCUMULATIVE

7. 本製品は 52018-8**5 の鉛フリー品である。

THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52018-8**5.

①適用 FFIX -82*6	8	8	7.11	1.27	52018-8846	
				0.76	-8836	
				0.38	-8826	
				0.1	-8816	
		6	5.08	1.27	-8646	
		4	3.05	1.27	-8446	
		2	1.02	1.27	52018-8246	
52018-8**6	ポジション	極数	(A)	金メッキ厚 (μmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.) (μmMIN.)	製品番号	
MODEL NO.	POSITION	CIRCUITS		MATERIAL No.		
				材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
				仕上げ FINISH	注及び表参照 SEE NOTES AND CHART	
				適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —	EDP. NO. — # —
				被覆外径 INS. RANGE	— # —	ENG. NO. SD-52018-001
05 ①	新規作成 RELEASED (J2004-4035)	M.NABEI	04/04/28	DRAWN BY 04/04/28 M.NABEI	CHK'D BY 04/04/28 K.TOJO	TITLE 名称 MODULAR JACK
記号	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY 04/04/28 M.SASAO	尺度 SCALE 4 - 1	HOUSING ASS'Y -LEAD FREE
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM						